Descrizione del prodotto

FINITURA: QUESTO BOARD SARÀ IMMERSIONE OGGETTO SECONDO IPC-6012.
LA SPESSORE SARA .050UM SUI NICKEL 3-6uM.

LA FORMAGGIA DEL COPPER RISPETTA MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE INCISCATI

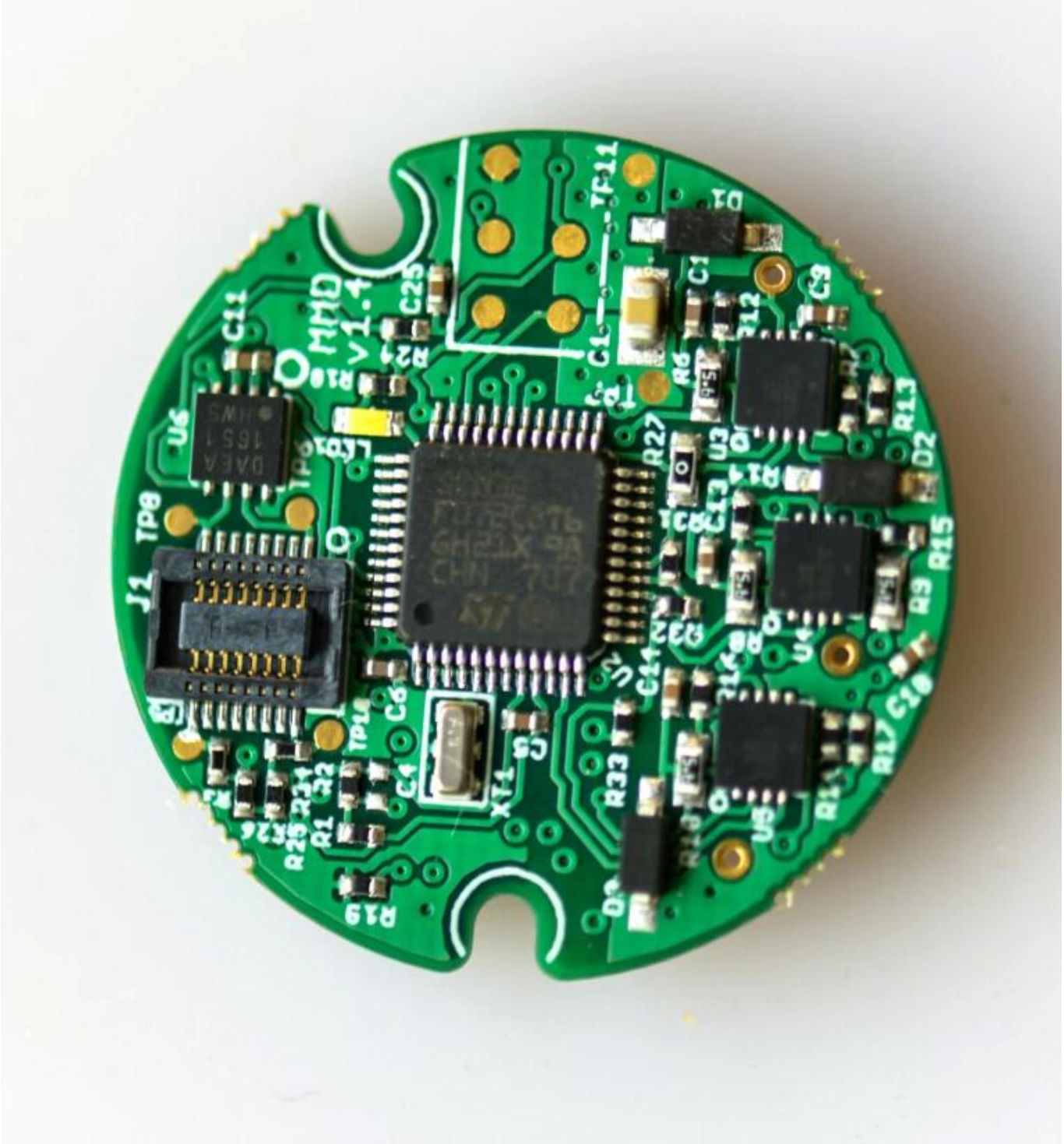
Imballare con film trasparente in bolle trasparente, 25 PCS / bag, mettere l'essiccante in fianco, inserire la carta di indicatore di umidità sul lato superiore
Struttura del livello

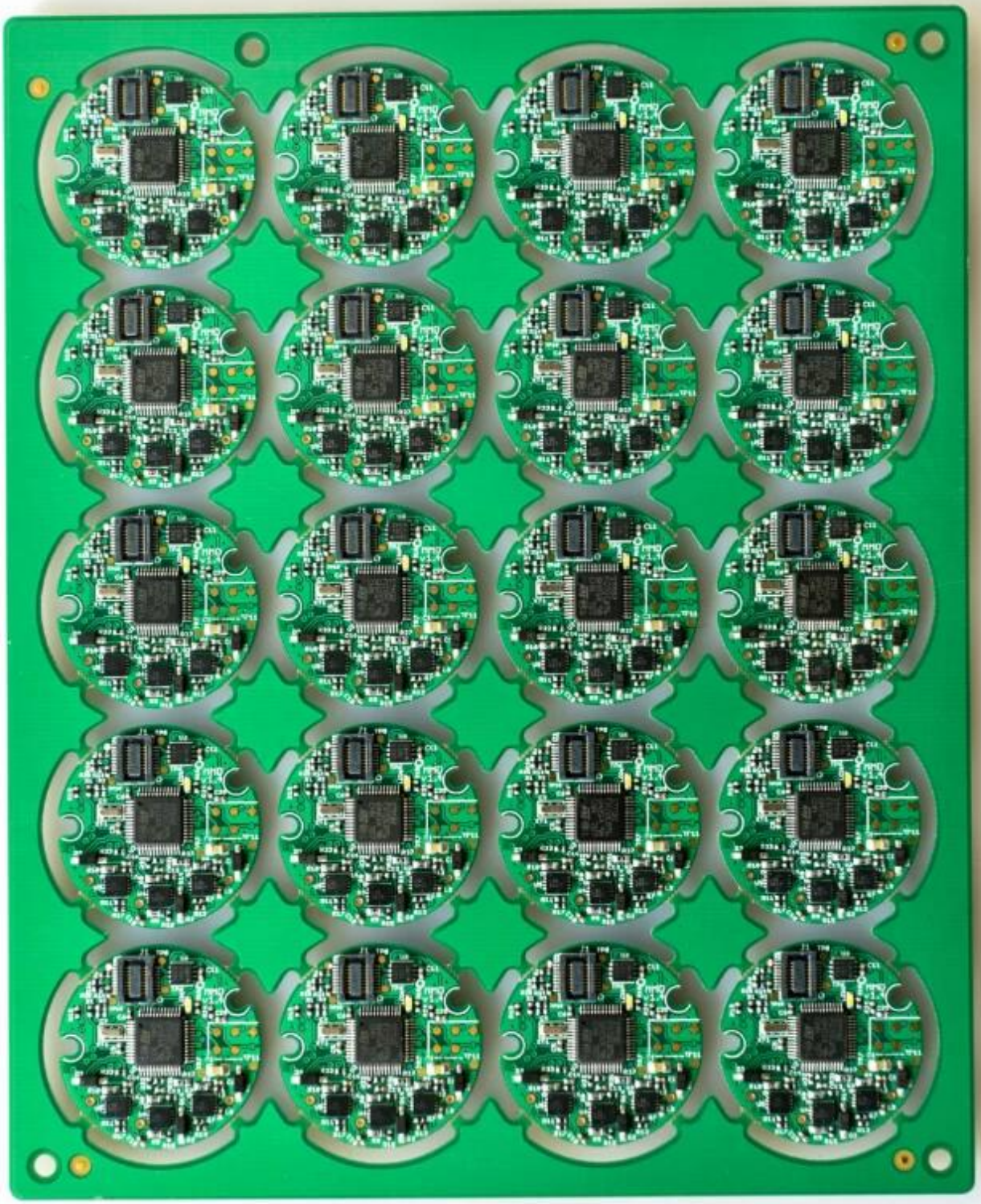
L1 ---------- HOZ
  - PP 7mil -
  - -
L2 ---------- 1OZ
  - CORE 9.05mil -
L3 ---------- 1OZ
  - -
  - PP 7mil -
L4 ---------- HOZ

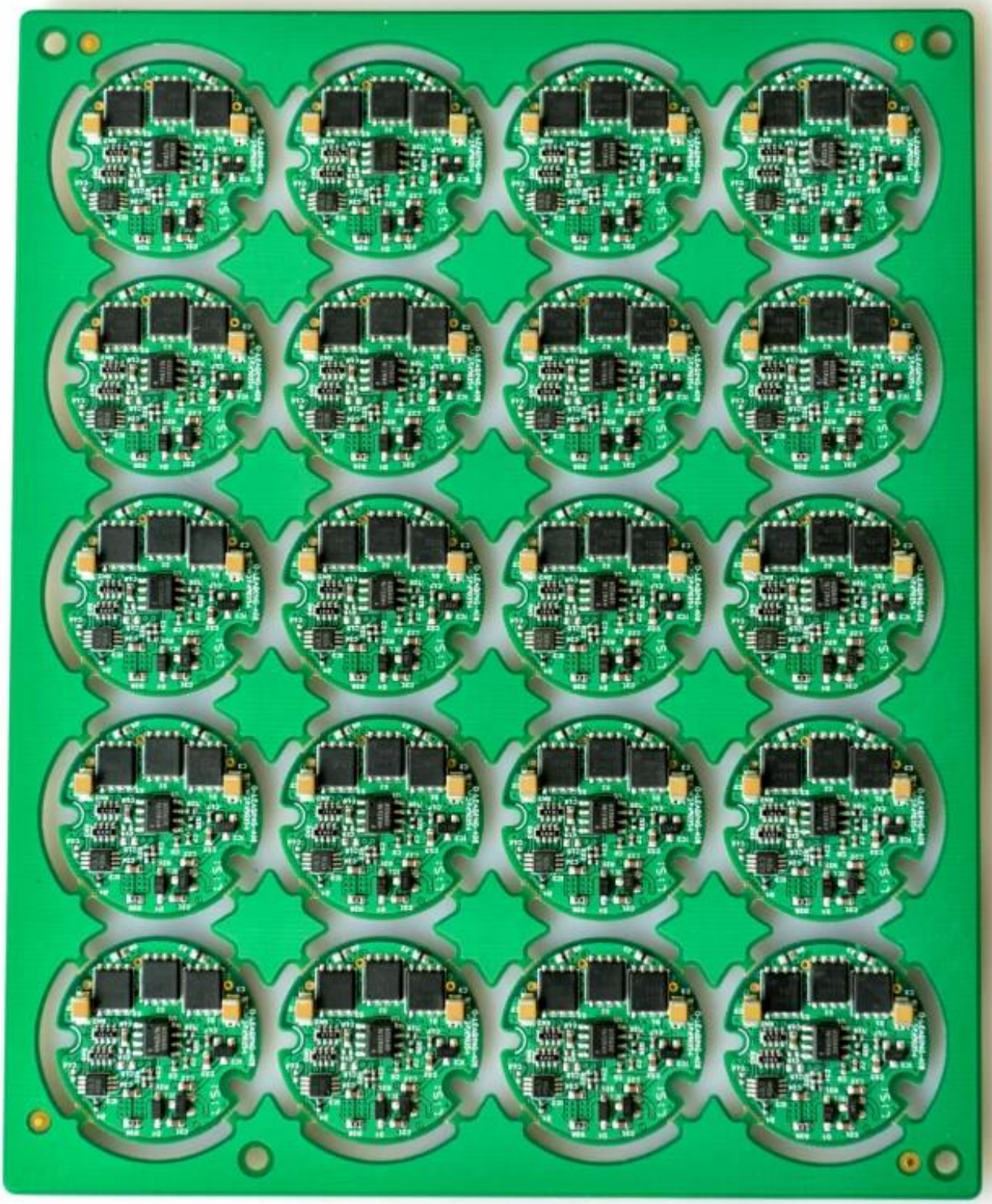
Definizioni del livello:

* .GCMT - Top maschera di rivestimento convenzionale
* .GTP - Top Paste saldanti
* .GTO - Top Silkscreen
* .GTS - Top Soldermask
* .GTL - Top Layer
---
* .G2L - Livello segnale interno 1
==========
* .G3L - Livello segnale interno 2
---
* .GBL - Livello inferiore
* .GBS - Bottom Soldermask
* .GBO - Silkscreen inferiore
* .GBP - Pasta di saldatura inferiore
* .GCMB - Maschera di rivestimento conformale inferiore

O-LEADING-408
R1%V.J E4/0354
B3L5
A91A
1003
4701
R3
R4
R28
D4
C21
IC1
IC2
IC3
C4
C5
C8
C22
C23
C24
C26
C15
C19
C18
C17
C3
S1
S2
S3
U1
RN2
RN3
R2
R5


MMD
V1.4
J1
TP8
U5
C11
C25
R29
R31
R32
R26
R1
R19
TP14
C4
XT1
R33
D4
U6
R17
R14
C10
R9
R15
D2
R13
U4
U3
R12
C9
D1
TF11
C1
R6
R27
C13
C14
R7





Fornitore di circuiti stampati, disegno del PCB in Cina